

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中“公司面临的内外部风险和应对措施”相关内容。

公司代码:688233 公司简称:神工股份
锦州神工半导体股份有限公司
2025 年 度 报 告 摘 要

(二)董事会决议和关联情况
公司于第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告审计机构,聘期一年。
(三)本年度报告涉及的未来发展规划及公司重大对外投资、并购重组等事项,均已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规履行了信息披露义务,敬请投资者关注。

7.董事会决议涉及的未来发展规划及公司重大对外投资、并购重组等事项,均已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规履行了信息披露义务,敬请投资者关注。
8.是否存在公司治理缺陷等需要披露的情况
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股, 期末持股数量, 比例%, 持有表决权股份数量. Lists major shareholders like 锦州神工半导体股份有限公司 and 普华永道会计师事务所.

锦州神工半导体股份有限公司
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

公告编号:2026-015
一、本次发行股票的基本情况
(一)发行对象
本次发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象,不超过35名。
(二)发行数量
本次发行股票的数量不超过10,000万股,募集资金总额不超过100,000万元。
(三)发行价格
本次发行股票的发行价格为人民币10.00元/股。

1.公司基本情况
1.1公司简介
1.2公司主要业务
1.3主要客户
1.4主要供应商

(一)利润分配方案的具体内容
经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为102,077,073.03元,公司拟以2025年度末总股本为基数,按照10%的比例计提法定盈余公积,计提金额为10,207,707.30元,计提后未分配利润为91,869,365.73元。

二、本次发行股票募集资金用途
本次发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,用于满足公司日常生产经营需要,提高公司运营效率,增强公司核心竞争力。

2.生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式,根据客户订单进行生产,确保产品质量和交货周期。
3.销售渠道
公司主要通过直销和经销两种方式进行销售,覆盖国内外主要市场。

(二)利润分配政策的决策程序
公司利润分配政策的制定和修改,须经公司董事会审议通过,并经股东大会批准。
(三)利润分配政策的执行情况
公司严格按照利润分配政策执行,按时足额发放股利,保障投资者的合法权益。

锦州神工半导体股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

公告编号:2026-016
一、会议基本情况
(一)会议名称
2025年年度股东大会
(二)会议时间
2026年3月21日
(三)会议地点
锦州神工半导体股份有限公司会议室

4.主要原材料
公司主要原材料包括硅片、光刻胶、蚀刻液等,均来自国内外知名供应商。
5.主要设备
公司主要设备包括光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备等,均为国际先进水平。

三、关联交易
(一)关联方
(二)关联交易
(三)关联交易定价
(四)关联交易决策程序

锦州神工半导体股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

公告编号:2026-017
一、会议基本情况
(一)会议名称
2025年年度股东大会
(二)会议时间
2026年3月21日
(三)会议地点
锦州神工半导体股份有限公司会议室

6.主要客户
公司主要客户包括国内外知名电子产品制造商,合作关系稳定。
7.主要供应商
公司主要供应商包括国内外知名原材料和零部件供应商。

四、募集资金使用
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用效果
(三)募集资金使用计划

锦州神工半导体股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

公告编号:2026-018
一、会议基本情况
(一)会议名称
2025年年度股东大会
(二)会议时间
2026年3月21日
(三)会议地点
锦州神工半导体股份有限公司会议室

8.主要客户
公司主要客户包括国内外知名电子产品制造商,合作关系稳定。
9.主要供应商
公司主要供应商包括国内外知名原材料和零部件供应商。

五、募集资金使用
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用效果
(三)募集资金使用计划

锦州神工半导体股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

公告编号:2026-019
一、会议基本情况
(一)会议名称
2025年年度股东大会
(二)会议时间
2026年3月21日
(三)会议地点
锦州神工半导体股份有限公司会议室

10.主要客户
公司主要客户包括国内外知名电子产品制造商,合作关系稳定。
11.主要供应商
公司主要供应商包括国内外知名原材料和零部件供应商。

六、募集资金使用
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用效果
(三)募集资金使用计划

锦州神工半导体股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

公告编号:2026-020
一、会议基本情况
(一)会议名称
2025年年度股东大会
(二)会议时间
2026年3月21日
(三)会议地点
锦州神工半导体股份有限公司会议室

12.主要客户
公司主要客户包括国内外知名电子产品制造商,合作关系稳定。
13.主要供应商
公司主要供应商包括国内外知名原材料和零部件供应商。

七、募集资金使用
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用效果
(三)募集资金使用计划

锦州神工半导体股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

公告编号:2026-021
一、会议基本情况
(一)会议名称
2025年年度股东大会
(二)会议时间
2026年3月21日
(三)会议地点
锦州神工半导体股份有限公司会议室

14.主要客户
公司主要客户包括国内外知名电子产品制造商,合作关系稳定。
15.主要供应商
公司主要供应商包括国内外知名原材料和零部件供应商。

八、募集资金使用
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用效果
(三)募集资金使用计划

锦州神工半导体股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知

公告编号:2026-022
一、会议基本情况
(一)会议名称
2025年年度股东大会
(二)会议时间
2026年3月21日
(三)会议地点
锦州神工半导体股份有限公司会议室